

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他（ ） ☐ 分析师会议 ☒ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☒ 电话会议
参与单位名称	2025 年 10 月 27 日 贝莱德基金、工银瑞信基金、汇丰晋信基金、建信基金、诺安基金、平安资管、上银基金、尚正基金、中信保诚基金等 2025 年 10 月 28 日 业绩说明会
时间	2025 年 10 月 27 日、2025 年 10 月 28 日
调研方式	线上会议
公司接待人员姓名	公司董事长兼总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民） 公司董事、董事会秘书、人事行政高级副总裁：石雯丽
投资者关系活动主要内容介绍	

公司介绍	芯原是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。 公司拥有自主可控的图形处理器 IP（GPU IP）、神经网络处理器 IP（NPU IP）、视频处理器 IP（VPU IP）、数字信号处理器 IP（DSP IP）、图像信号处理器 IP（ISP IP）和显示处理器 IP（Display Processing IP）这六类处理器 IP，以及 1,600 多个数模混合 IP 和射频 IP。 基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AIPC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。 为顺应大算力需求所推动的 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）发展的趋势，芯原正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的研发和产业化。 基于公司独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式，目前公司主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。 芯原在传统 CMOS、先进 FinFET 和 FD-SOI 等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。此外，根据 IPnest 在 2025 年的统计，从半导体 IP 销售收入角度，芯原是 2024 年中国大陆排名第一、全球排名第八的半导体 IP 授权服务提供商；2024 年，芯原的知识产权授权使用费收入排名全球第六。根据 IPnest 的报告和企业公开数据，在全球排名前十的 IP 企业中，芯原的 IP 种类排名前二。 得益于公司近两年在手订单持续保持高位，随着订单的不断转化，公
-------------	--

	司研发资源陆续投入客户项目，公司 2025 年第三季度营业收入延续了第二季度环比大幅增长的趋势，2025 年第三季度实现营业收入 12.81 亿元，单季度收入创公司历史新高，环比大幅增长 119.26%，同比大幅增长 78.38%；公司 2025 年第三季度盈利能力大幅提升，单季度亏损同比、环比均实现大幅收窄，收窄幅度分别为 75.82%、73.02%。 公司技术能力业界领先，并持续获得全球优质客户的认可，2025 年第三季度公司新签订单 15.93 亿元，同比大幅增长 145.80%，其中 AI 算力相关的订单占比约 65%。公司 2025 年前三季度新签订单 32.49 亿元，已超过 2024 年全年新签订单水平。公司在手订单已连续八个季度保持高位，截至 2025 年第三季度末在手订单金额为 32.86 亿元，持续创造历史新高。公司 2025 年第三季度末在手订单中来自系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商和车企等客户群体的订单占比为 83.52%。公司 2025 年第三季度末在手订单中，一站式芯片定制业务在手订单占比近 90%，且预计一年内转化的比例约为 80%，为公司未来营业收入增长提供了有力的保障。
交流问答	问题：请问公司如何看待 AI/AR 眼镜等增量市场的发展，以及公司在该领域有哪些技术布局？ 回复：在边缘人工智能终端产品中，以 AI/AR 眼镜为代表的智慧可穿戴设备被认为是继智能手机之后的下一个十亿级出货量的产品，这类设备可搭载更为自然的人机交互界面和越来越强大的本地 AI 处理能力，创新人们的数字生活和社交。芯原拥有面向相关领域的极低功耗高性能芯片设计平台，可以打造适应不同功率模式的产品，满足超轻量实时在线、低功耗以及全性能的全场景应用。目前，在 AI/AR/VR 眼镜领域，公司已为某知名国际互联网企业提供 AR 眼镜的芯片一站式定制服务，此外还有数家全球领先的 AI/AR/VR 客户正在与芯原进行合作。

问题：公司量产业务收入增速较快，主要来自哪些领域的需求驱动？

回复：2025 年前三季度，为公司贡献营业收入的量产出货芯片共 112 款，公司实现量产业务收入 10.16 亿元，同比增长 76.93%，前三季度收入已超去年全年收入水平。公司量产业务快速增长，主要受益于数据处理、端侧 AI 领域的需求扩张。

问题：请问公司如何看待未来研发投入变化趋势？

回复：芯原所处的集成电路设计行业，是集成电路产业的上游行业，相对产业链中其他行业而言，需要更早地进行针对性的布局和研发。因此集成电路设计行业呈现投资周期长，研发投入大的行业格局。通过 20 余年的高研发投入和深度积累，公司已经在半导体 IP 和芯片定制领域形成了丰富的技术池和服务经验。未来，随着公司芯片设计业务订单增加，预计未来公司会将更多研发资源投入客户项目，研发投入占营业收入比重将有所下降。

问题：请问公司如何看待三季度毛利率的变化？

回复：公司毛利率同比变化主要由于收入结构变化等因素所致。公司一站式芯片定制服务业务模式与传统芯片设计公司在销售风险、库存风险、技术支持费用等方面有所不同，公司仅需以相对稳定的量产业务团队管理日益增长的量产业务，具有可规模化优势。因此，基于公司独特的商业模式，综合毛利率并非评估公司盈利能力的唯一指标，虽然公司量产业务毛利率相对半导体 IP 授权服务业务较低，但该业务产生的毛利大部分可贡献于净利润。

问题：请问公司在 SerDes 领域的技术储备有哪些，未来布局计划是怎样的？

回复：随着数据中心对网络通信速度和性能需求的不断提升，高速接口技术也迎来关键发展时期，这其中最为关键的高速 SerDes 接口 IP 已经成为了近年来研究的热点。该接口 IP 实现了高速串行通信链路的升级，提供更多带宽和更高端口密度，提升数据中心效率，为大数据的持续发展奠定基础。

作为半导体 IP 和一站式芯片定制服务平台的行业龙头，芯原多年以来一直坚持以内部自主研发为主，在自主创新的同时适时对芯原所需的技术和团队进行准确的收购和引进、吸收再创新，在此过程中，芯原的 IP 得到了充实，芯片定制能力也逐渐变强。未来，公司将继续依托平台化公司的行业理解，积极推进产业生态建设，视业务需要择机进行与公司战略发展方向相一致的投资或并购公司，并将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

问题：在当前人工智能领域快速发展的形势下，公司如何看待未来发展前景和营收增长情况？

回复：基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AI PC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。

受益于 AI 浪潮，公司订单饱满，2025 年第三季度公司新签订单 15.93 亿元，同比大幅增长 145.80%，其中 AI 算力相关的订单占比约 65%。公司在手订单已连续八个季度保持高位，截至 2025 年第三季度末在手订单金额为 32.86 亿元，持续创造历史新高。公司 2025 年第三季度末在手订单中来自系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商和车企等客户群体的

	订单占比为 83.52%。公司 2025 年第三季度末在手订单中，一站式芯片定制业务在手订单占比近 90%，且预计一年内转化的比例约为 80%，为公司未来营业收入增长提供了有力的保障。
--	--